

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2026-004

无锡芯朋微电子股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信额度
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|
| 上海复矽微电子有限公司（以下简称“上海复矽”） | 6,000.00 万元 | 0 万元 | 否 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 10,020.77 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 4.03 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <div><input type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div> |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足经营和发展需求，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“芯朋微”）全资子公司上海复矽拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 6,000 万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。其中，上海复矽拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请两期借款，分别为人民币 500 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“管理中心”）为上述借款提供连带责任保证担保，同时公司向管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体的担保金额、担保范围和担保期限等以公司向管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。除此之外，按照银行要求，公司需为上海复矽申请综合授信提供连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意为全资子公司上海复矽申请银行授信提供不超过人民币 6,000 万元的担保额度。本议案无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

| | |
|-----------------|-------------|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | 上海复矽微电子有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 芯朋微持股 100% |
| 法定代表人 | 易扬波 |

| | | | |
|------------|---|--|-----------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91310120MA7B5J3243 | | |
| 成立时间 | 2021-09-01 | | |
| 注册地 | 中国(上海)自由贸易试验区环科路 515 号 313 室 | | |
| 注册资本 | 1,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；机械设备销售；电器辅件销售；家用电器销售；五金产品零售；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 437.55 | 462.34 |
| | 负债总额 | 2,325.23 | 1,714.35 |
| | 资产净额 | -1,887.68 | -1,252.00 |
| | 营业收入 | 154.30 | 264.90 |
| | 净利润 | -1,519.82 | -690.96 |

三、担保协议的主要内容

全资子公司及公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为全资子公司及公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司对全资子公司担保符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解全资子公司流动资金需求，有助于全资子公司的持续发展，符合公司整体发展战略，符合公司整体利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2026 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保，并同意授权公司管理层代表公司签署相关的所有合同、协议等有关法律文件。董事会认为：公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保，是基于对全资子公司业务情况的预计，符合公司及全资子公司生产经营的需要，是为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司对外担保总额为 10,020.77 万元，为公司对子公司的担保及子公司对子公司员工租房的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的 3.40%和 4.03%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日